

10月31日(木)10:00-12:30  
**KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30**  
(受付・ウェルカムコーヒー 9:30 開始)

司会:中村 孝(大阪大学)  
◆来賓挨拶  
京都府知事 (予定)  
京都市長 (予定)  
◆基調講演:  
「半導体の成長を支える製造装置の戦略(仮題)」  
東京エレクトロン㈱ 経営戦略本部 経営戦略室 室長 西村和哲  
◆基調講演  
「先端技術総合研究所における研究戦略(仮題)」  
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 所長 高林幹夫  
◆基調講演  
「電子デバイス産業は異次元の成長段階に突入したのだ!!  
~シリコン列島ニッポンによる新たな国おこし~」  
㈱産業タイムズ社 取締役会長 泉谷 渉

◆特別講演  
「生成AIが牽引し再成長に向かう半導体・装置・電子部品業界」  
㈱産業タイムズ社 大阪支局 支局長  
電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛  
◆特別講演  
「2025年度以降の電子機器・半導体市場  
~新たな半導体時代の始まり~(仮題)」  
インフォマティクス総合会社 C&Dコンサルティング 南川 明  
◆特別講演  
「フラットパネルディスプレイ・CMOSセンサ業界、スマホなど完成品  
業界見通し:25年、AI機能がスマホやPC買換えを牽引する?  
技術変化や今後の注目点は何か?」  
みずほ証券㈱ エキイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジ  
ー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫

11月1日(金)9:20-11:45  
**KM-2 マーケティングセッション**  
9:20-11:45 (受付 8:50 開始)

◆特別講演  
「生成AIが牽引し再成長に向かう半導体・装置・電子部品業界」  
㈱産業タイムズ社 大阪支局 支局長  
電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛  
◆特別講演  
「2025年度以降の電子機器・半導体市場  
~新たな半導体時代の始まり~(仮題)」  
インフォマティクス総合会社 C&Dコンサルティング 南川 明  
◆特別講演  
「フラットパネルディスプレイ・CMOSセンサ業界、スマホなど完成品  
業界見通し:25年、AI機能がスマホやPC買換えを牽引する?  
技術変化や今後の注目点は何か?」  
みずほ証券㈱ エキイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジ  
ー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫

◆特別講演  
「フラットパネルディスプレイ・CMOSセンサ業界、スマホなど完成品  
業界見通し:25年、AI機能がスマホやPC買換えを牽引する?  
技術変化や今後の注目点は何か?」  
みずほ証券㈱ エキイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジ  
ー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫

コース  
**【A】**

**環境エネルギー**

**【B】**  
**新世代デジタル**

**【C】**  
**The 半導体**

**【D】**  
**跳躍の最先端パッケージ・実装技術**

**【E】**  
**特別セッション**

10月31日(木)14:00-16:40  
**A-1 環境エネルギー総論**

戸所義博(イーセップ)/山崎治(シャープフロンティアAT)  
◆GX総論(仮題)  
経済産業省GXグループ GX推進企画室 高島 大樹  
◆ペロブスカイト太陽電池(仮題)  
積水化学工業㈱ PVプロジェクトヘッド 森田 健晴  
◆カーボンニュートラルに向けた自動車技術(仮題)  
早稲田大学 名誉教授 大聖 泰弘

**B-1 DX総論**  
浦岡行治(NAIST)/酒井滋樹(日新イオン機器)  
◆生成AIが可能にする新しいDX:医療現場の事例  
奈良先端科学技術大学院大学 教授 荒牧 英治  
◆メタバース市場拡大と最新のビジネス(仮題)  
クラスター㈱ 成田 暁彦  
◆電子デバイス業界におけるDXの進化とデータプラットフォーム  
の役割(仮題)  
AOSテクノロジーズ㈱ 代表取締役社長 佐々木 隆仁

**C-1 半導体の市場・技術動向**  
三富士道彦(ROOM)/廣田良浩(ワイドヴィル)  
◆Si SiC パワー半導体の技術動向・市場動向(仮題)  
九州大学 システム情報科学研究院 教授 寺島 知秀  
◆デバイス視点からシステム思考へ  
~GaNデバイス普及の課題と新ビジネスモデル~  
ROOM㈱ LSI事業本部 電源LSI事業担当  
パワーステージ商品開発部 統括課長 吉持 賢一  
◆環境への取り組み強化に向けたサプライチェーンの取り組み  
「E-COMPASS」(仮題)  
東京エレクトロン㈱  
開発戦略部、環境技術戦略Gr. グループリーダー 梶 公知

**D-1 最新のパッケージ・実装技術動向**  
森川泰宏(ULVAC)/藤原健典(東レ)  
◆先端パッケージの技術動向(仮題)  
㈱SBRテクノロジ 代表取締役 西尾俊彦  
◆CMOSイメージセンサにおける3D積層技術の現状と展望(仮題)  
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱  
第2研究部門 部門長 岩元 勇人  
◆Process Challenges for High Bandwidth Memory(HBM)  
マイクロメモリジャパン㈱ Technology Development  
Process Development Sr Manager, BEOL 横井 直樹

**E-1 大学セッション(無料)**  
マテリアル先端リサーチインフラ  
土屋智由(京都大学)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)  
◆フレキシブルエレクトロニクスの研究開発と社会実装  
~脳波センシングとAIが生み出す医療・ヘルスケアの可能性  
大阪大学 産業科学研究科 教授 関谷 毅  
◆物境界面融合技術を使用した先端デジタルスキデバイス  
の開発  
山形大学大学院 有機材料システム研究科 准教授 関根 智仁  
◆CNT新繊維糸を用いた布状熱電変換素子(仮題)  
奈良先端科学技術大学院大学 教授 中村 雅一  
◆材料の熱的特性を制御したフレキシブルサーマルデバイスの開発(仮題)  
京都大学 准教授 廣谷 潤

11月1日(金)12:35-14:50  
**A-2 カーボンリサイクル**

松浦正純(FLOSFA)/山崎治(シャープフロンティアAT)  
◆カーボンリサイクルにおける「はかる」技術  
編組機製作所 エネルギー・環境本部 エネルギー・環境戦略室 室長 池田 輝彦  
◆CO2を炭素源とするカーボンリサイクル型SiC合成  
東北大学大学院工学研究科 応用化学専攻 助教 福島 潤  
◆メタネーション関連(仮題)  
大阪ガス㈱ エグゼクティブフェロー  
エネルギー技術研究所 SOECメタネーション開発室 統括室長 大西 久男

**B-2 次世代通信**  
妹尾和則(NTT研究所)/松村善夫(パナソニック)  
◆光電ハイブリッドパッケージ基盤の研究開発(仮題)  
国立研究開発法人産業技術総合研究所 天野 達  
◆次世代無線通信への Analog Radio over Fiber技術応用  
に関する村田製作所の取り組み  
村田製作所 技術・事業開発本部 次世代通信事業推進課 シニアリサーチャー 西田 翼

**C-2 装置技術・プロセス技術**  
森義弘(SCREEN)/廣田良浩(ワイドヴィル)  
◆次世代デバイスを支える成膜技術動向  
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱  
事業開発企画室 室長 柴田 哲弥  
◆先端半導体プロセスを支えるCMP装置と技術  
㈱住原製作所 技術・知的財産統括部 技監 楢山 浩園  
◆AIで切り拓く先端欠陥検査技術の開発  
㈱SCREENアドバンスドシステムソリューションズ  
開発部 開発担当課長 岡山 敏之

**D-2 光通信デバイス**  
森川泰宏(ULVAC)/不破保博(元ROOM)  
◆Co-package optics から光電融合に向けた  
光インターフェースの最新動向  
一般財団法人 光産業振興協会 開発部 部長代理 杉立 厚志  
◆シリコンフォトニクスと薄膜転写による異種材料集積  
国立研究開発法人産業技術総合研究所  
プラットフォームフォトニクス研究センター  
シリコンフォトニクス研究チーム 主任研究員 高 磊

**E-2 核融合**  
酒井滋樹(日新イオン機器)/加藤千晴(村田製作所)  
◆フュージョンエネルギー実現に向けた学術研究からのアプローチ  
(仮題)  
核融合科学研究所  
フュージョンエネルギー産学連携研究室長 教授 安原 亮  
◆発電をはるかに速くレーザーフュージョンエネルギー開発  
大阪大学 レーザー科学研究所 所長 名誉教授 兒玉了祐  
◆JT-80SAの概要と今後の計画(仮題)  
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構  
那賀フュージョン科学技術研究所 主任技術員 島山 昭一

11月1日(金)15:15-17:30  
**A-3 パワーエレクトロニクス**

佐藤高史(京都大学)/中村孝(大阪大学)  
◆パワーエレクトロニクス機器の高効率・高電力密度進化を支える  
回路技術とモデルベース技術  
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 モータ駆動システム技術部  
推進電力変換技術グループ 主席研究員 近藤 亮太  
◆電力強化のためのSiC半導体技術  
(一社)SiCアライアンス 監事 東京工業大学名誉教授 嶋田 隆一  
◆車両分解により見えてきた日米欧中のxEVの現在地と2030年へ  
に向けて半導体が執るべき技術戦略  
名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 山本 真哉

**B-3 AI**  
加藤千晴(村田製作所)/  
◆アダプティブAIについて(仮題)  
㈱レベリング 柳谷 智宣  
◆組み込みAIの技術動向と電力効率10倍を実現する  
ルネサスのAIqセラセラ(DRP-AD)の御紹介  
ルネサスエレクトロニクス㈱ エンベディッドプロセスプロダクトグループ  
エンベディッドプロセス第1事業部 主管技師 野瀬 浩一  
◆エッジAIの社会実装における現実と可能性  
㈱村田製作所 通信モジュール事業部  
コネクティブティモジュール開発部 戦略企画課 マネージャー 飯塚 雄彦

**C-3 デバイス技術・応用**  
山本浩之(マイクロン)/森義弘(SCREEN)  
◆Innovations and Challenges in the latest DRAM  
マイクロンメモリジャパン㈱  
DIRECTOR, DRAM Integration Technology 藤田 博文  
◆強靱メモリの展望(仮題)  
東京大学 工学系研究センター  
システムデザイン研究センター(d.lab) 准教授 小林 正治  
◆半導体設計でのEDAツールにおけるAIとマシンラーニングの状況  
とこれから~設計のAI化は設計者不足を解消するのか?~  
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社  
アカウント・テクニカル・エグゼクティブ ディレクター 牧 井 徹

**D-3 高密度実装**  
不破保博(元ROOM)/藤原健典(東レ)  
◆Si貫通電極ウェーハ全自動削削装置について(仮題)  
㈱岡本工作機械製作所 技術開発本部 ナノプロセス技術部  
要素プロセス開発課 課長 三井 貴彦  
◆LIDE-Advanced packaging-Wafer/Panel-Level Packaging分野に  
おけるガラス素材の可能性  
LPKF Laser & Electronics ㈱ セールズダイレクター 上館 寛之  
◆次世代高密度パッケージにおける実装技術動向(仮題)  
東レエンジニアリング㈱ メタロフソリューションズ事業本部  
第一事業部 営業部 営業技術 T 主任部員 河村 知範

**E-3 やはり目が離せない! アジア半導体産業の動き  
中・韓・印 アジア半導体産業の最新線を追う!**  
松下晋司(産業タイムズ社)/戸所義博(イーセップ)  
◆中国・インド・半導体産業の動き(仮題)  
㈱産業タイムズ社 取締役副社長  
電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏  
◆国家総力戦で臨む韓国半導体育成戦略に迫る  
~AI半導体の火蓋が噴出する~  
㈱産業タイムズ社 ソウル支局長 巖 在漢